



2018年9月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト ラ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 林 為 平
(コード番号：6235 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 部 長 高 橋 俊 典
(TEL. 049-239-3381)

新型水平スパッタ装置の開発完了について

弊社は新型水平スパッタ装置（OWLS-1800）を開発完了し、受注を開始いたしました。特徴は、ウエハーサイズ12インチとこれまでになかった最大サイズの成膜を実現し、従来、ウエハー基盤を縦型に設置して成膜していた方式を、水平に設置することで成膜の均質性を高め、成膜歩留まりの向上も実現しました。また、装置内に真空ロボットを組み込むことで、高速かつクリーンな基板搬送が出来、さらに半導体工程ウエハー搬送モジュール規格に対応することで、お客様の自動化ライン組み込みが可能となり、生産効率向上に貢献いたします。

本スパッタ装置は光学半導体融合技術を結集した新型装置で、半導体分野における受注獲得が可能になると思われ、すでに受注も獲得し始めております。当社の技術的に最高水準の光学薄膜装置製品ラインアップに、本装置が新たに追加されることにより、更なる市場ニーズへの対応が可能になると見込まれます。

以上